# 厦门大学 RoboMaster 事故报告

# 调试事故报告

#### 事故现象:

DAPLink 调试器着火,上位机黑屏。

#### 现场考证:

调试器亚克力保护板出现大面积烧焦痕迹,事故现场复原位置的碳纤板出现烧焦痕迹。



## 板级考证:

输出电容 3.3V 区域阻焊层烧毁,输出电容 GND 区域阻焊层及铜箔被炸毁,主控芯片烧毁,烧毁路径分布在 3.3V 管脚。

#### 事故机理:

碳纤板接触输出电容,输出电容短路的同时产生短时间高电流脉冲尖峰,造成输出电容承受电流应力超过耐流值爆炸;同时脉冲尖峰反向击穿 LDO,电流倒灌至上位机。

## 保护失效机理:

DAPLink 保护机制由两部分组成: 自恢复保险丝提供的 500mA 过流保护, LDO 提供的热过载保护和短路保护。

事故由高电流脉冲尖峰引发,平均电流值不足以触发以上两种保护机制,导致保护失效。

# 事故定性:

板级元件与外部导电体误接触导致的短路事故,造成上位机端口损害、调试器烧毁,后果较严重,经济损失较大。

#### 整改方案:

- 1.对现有保护壳存在的漏洞进行迭代;
- 2.调试环节增加隔离模块或器件。

电控事故调查组 2021.04.14

